

# 2024年3月期 第3四半期 決算説明会

2024年2月1日

代表取締役社長  
谷本 秀夫



**1 2024年3月期 第3四半期 決算概要**

**2 2024年3月期 業績予想**

**3 政策保有株式の活用検討状況**

- 1 2024年3月期 第3四半期 決算概要**
- 2 2024年3月期 業績予想
- 3 政策保有株式の活用検討状況

(単位：百万円)

	2023年3月期 第3四半期累計	2024年3月期 第3四半期累計	増減金額	増減率
売上高	1,526,497	1,492,672	-33,825	-2.2%
営業利益	113,884 (7.5%)	79,844 (5.3%)	-34,040	-29.9%
税引前利益	162,756 (10.7%)	125,638 (8.4%)	-37,118	-22.8%
親会社の所有者に 帰属する四半期利益	118,783 (7.8%)	90,366 (6.1%)	-28,417	-23.9%

平均為替 米ドル	137円	143円
レート ユーロ	141円	155円

注：（ ）内の数字は売上高比率

当社主要市場における需要減少、及び生産設備の稼働率低下等を主因に、減収減益

(単位：百万円)

	2023年3月期 第3四半期累計	2024年3月期 第3四半期累計	増減金額	増減率
設備投資額	127,137 (8.3%)	105,242 (7.1%)	-21,895	-17.2%
有形固定資産 減価償却費	80,330 (5.3%)	82,231 (5.5%)	1,901	2.4%
研究開発費	69,530 (4.6%)	77,481 (5.2%)	7,951	11.4%

注：（ ）内の数字は売上高比率

足元の需要状況に応じて、一部設備投資を来期以降へ延期

# 2024年3月期 第3四半期累計 事業セグメント別売上高



(単位：百万円)

事業セグメント別 売上高	2023年3月期 第3四半期累計		2024年3月期 第3四半期累計		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	<b>453,238</b>	<b>29.7%</b>	<b>432,152</b>	<b>29.0%</b>	<b>-21,086</b>	<b>-4.7%</b>
産業・車載用部品	147,163	9.6%	167,216	11.2%	20,053	13.6%
半導体関連部品	284,764	18.7%	242,676	16.3%	-42,088	-14.8%
その他	21,311	1.4%	22,260	1.5%	949	4.5%
<b>電子部品</b>	<b>290,538</b>	<b>19.1%</b>	<b>262,628</b>	<b>17.6%</b>	<b>-27,910</b>	<b>-9.6%</b>
<b>ソリューション</b>	<b>792,643</b>	<b>51.9%</b>	<b>810,476</b>	<b>54.3%</b>	<b>17,833</b>	<b>2.2%</b>
機械工具	238,368	15.6%	235,406	15.8%	-2,962	-1.2%
ドキュメントソリューション	318,476	20.9%	325,934	21.8%	7,458	2.3%
コミュニケーション	147,155	9.6%	161,656	10.8%	14,501	9.9%
その他	88,644	5.8%	87,480	5.9%	-1,164	-1.3%
その他の事業	17,091	1.1%	14,176	0.9%	-2,915	-17.1%
調整及び消去	-27,013	-1.8%	-26,760	-1.8%	253	—
<b>売上高</b>	<b>1,526,497</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,492,672</b>	<b>100.0%</b>	<b>-33,825</b>	<b>-2.2%</b>

# 2024年3月期 第3四半期累計 事業セグメント別利益

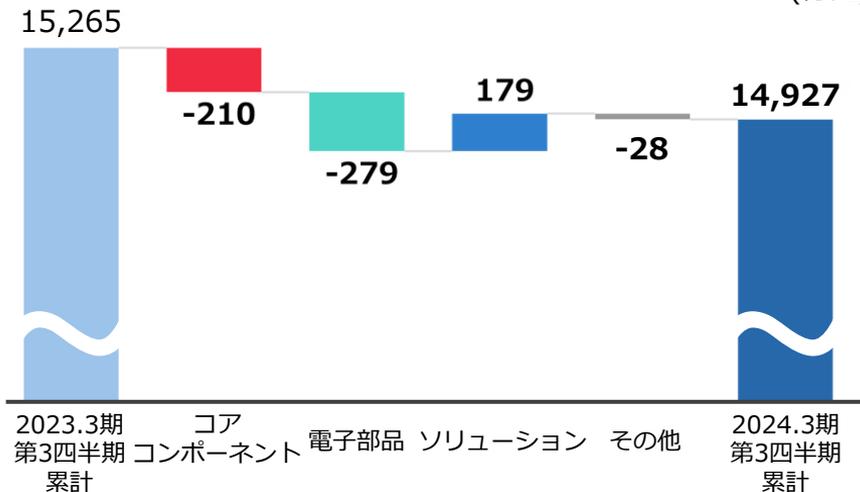


(単位：百万円)

事業セグメント別 利益	2023年3月期 第3四半期累計		2024年3月期 第3四半期累計		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	<b>71,148</b>	<b>15.7%</b>	<b>45,466</b>	<b>10.5%</b>	<b>-25,682</b>	<b>-36.1%</b>
産業・車載用部品	17,685	12.0%	18,873	11.3%	1,188	6.7%
半導体関連部品	56,296	19.8%	26,388	10.9%	-29,908	-53.1%
その他	-2,833	—	205	0.9%	3,038	—
<b>電子部品</b>	<b>39,572</b>	<b>13.6%</b>	<b>13,033</b>	<b>5.0%</b>	<b>-26,539</b>	<b>-67.1%</b>
<b>ソリューション</b>	<b>36,480</b>	<b>4.6%</b>	<b>46,817</b>	<b>5.8%</b>	<b>10,337</b>	<b>28.3%</b>
機械工具	20,097	8.4%	12,742	5.4%	-7,355	-36.6%
ドキュメントソリューション	21,981	6.9%	28,653	8.8%	6,672	30.4%
コミュニケーション	-5,553	—	2,356	1.5%	7,909	—
その他	-45	—	3,066	3.5%	3,111	—
その他の事業	-20,016	—	-32,067	—	-12,051	—
<b>事業利益 計</b>	<b>127,184</b>	<b>8.3%</b>	<b>73,249</b>	<b>4.9%</b>	<b>-53,935</b>	<b>-42.4%</b>
本社部門損益等	35,572	—	52,389	—	16,817	47.3%
<b>税引前利益</b>	<b>162,756</b>	<b>10.7%</b>	<b>125,638</b>	<b>8.4%</b>	<b>-37,118</b>	<b>-22.8%</b>

## 売上高

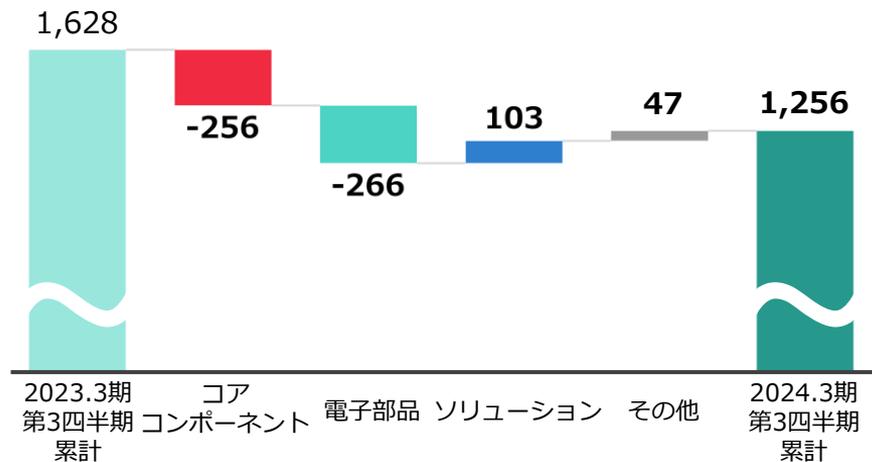
(億円)



ソリューションが増収となったものの、コアコンポーネント及び電子部品における主要製品の需要減少の影響を主因に減収

## 税引前利益

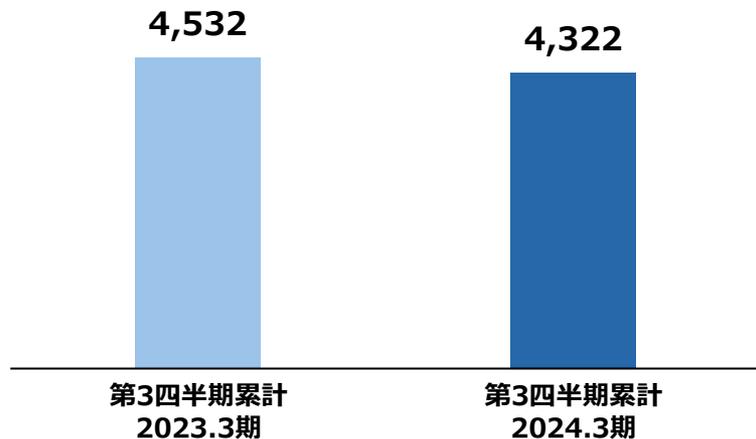
(億円)



コアコンポーネント及び電子部品における受注減少に伴う生産設備の稼働率低下や、グループ全体の労務費・研究開発費の増加を主因に減益

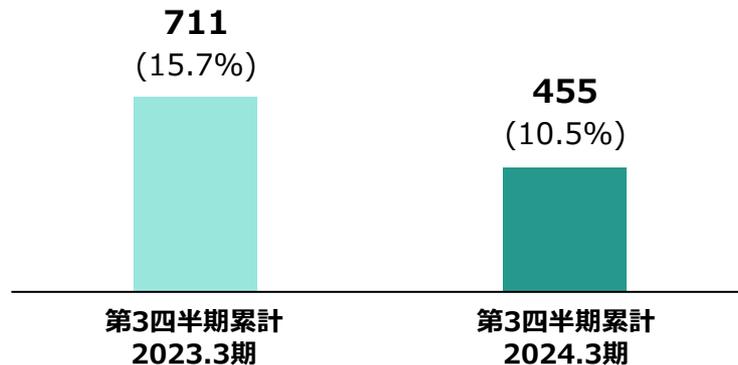
売上高

(億円)



事業利益(利益率)

(億円)



業績概況

<vs 2023.3期 第3四半期累計 △4.7%>

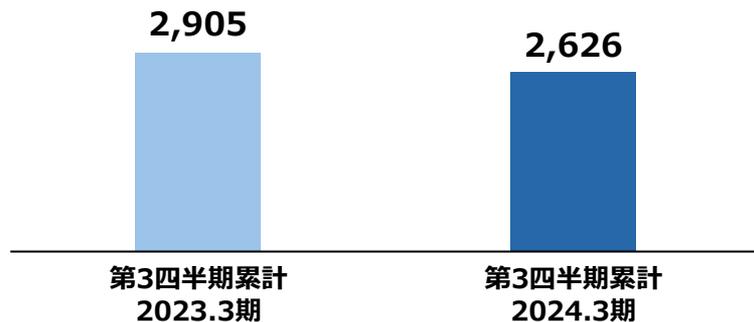
- スマートフォン市場向けセラミックパッケージ、及び情報通信インフラ市場向け有機基板の市況軟化を主因に減収

<vs 2023.3期 第3四半期累計 △36.1%>

- スマートフォン市場向けセラミックパッケージ、及び情報通信インフラ市場向け有機基板の販売減少に加え、減価償却費の増加等により減益

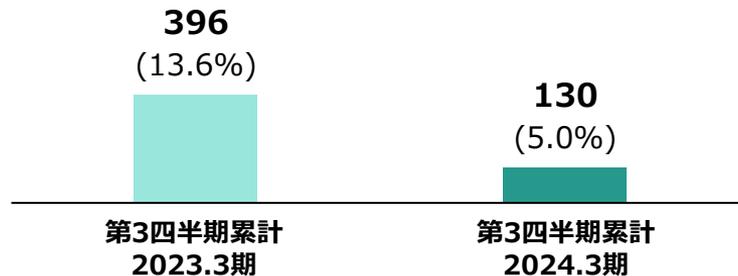
## 売上高

(億円)



## 事業利益(利益率)

(億円)



<vs 2023.3期 第3四半期累計  $\Delta$ 9.6%>

- 情報通信市場向けコンデンサや水晶部品等における在庫調整、及び需要減少を主因に減収

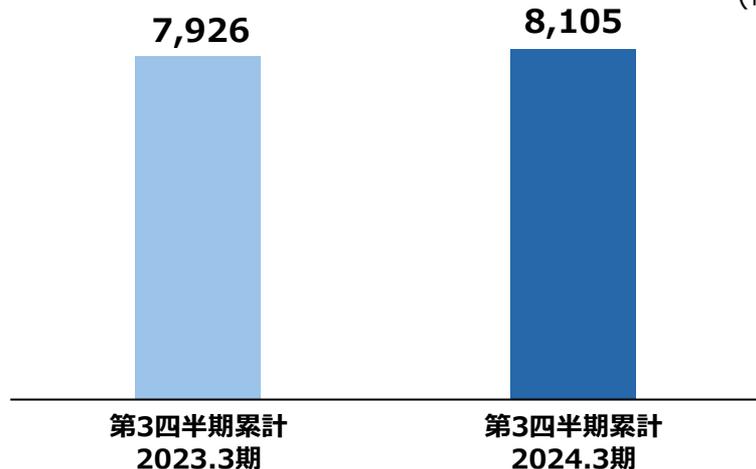
<vs 2023.3期 第3四半期累計  $\Delta$ 67.1%>

- 稼働率の低下に伴う原価率の悪化に加えて、原材料費の上昇等の影響もあり、大幅減益

業績概況

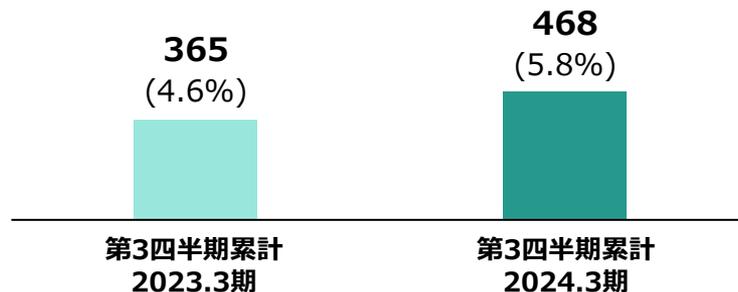
## 売上高

(億円)



## 事業利益(利益率)

(億円)



## 業績概況

## &lt;vs 2023.3期 第3四半期累計 +2.2%&gt;

- 機械工具: 切削工具事業の在庫調整の影響で減収
- ドキュメントソリューション: 円安効果等が寄与し増収
- コミュニケーション: 情報通信サービス事業が増収

## &lt;vs 2023.3期 第3四半期累計 +28.3%&gt;

- 増収効果に加え、前期に着手したコミュニケーション事業の構造改革に伴う収益性改善の進展により増益

1 2024年3月期 第3四半期 決算概要

**2 2024年3月期 業績予想**

3 政策保有株式の活用検討状況

# 2024年3月期 業績予想 (1)



(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期予想		増減金額	
		前回予想 (11月公表)	今回予想 (2月公表)	前期比	前回予想比
売上高	2,025,332	2,050,000	2,000,000	-25,332	-50,000
営業利益	128,517 (6.3%)	120,000 (5.9%)	95,000 (4.8%)	-33,517	-25,000
税引前利益	176,192 (8.7%)	170,000 (8.3%)	140,000 (7.0%)	-36,192	-30,000
親会社の所有者に 帰属する当期利益	127,988 (6.3%)	123,000 (6.0%)	100,000 (5.0%)	-27,988	-23,000
基本的EPS(円)	89.15	86.89	70.76		
平均為替 米ドル	135円	140円	143円		
レート ユーロ	141円	152円	155円		

注1: ( ) 内の数字は売上高比率  
 注2: 2024年3月期予想の基本的EPSは前回予想は2024年3月期第2四半期累計、今回予想は同第3四半期累計の期中平均株式数を用いて算出(2024年1月の株式分割後の基準)

半導体関連や情報通信関連市場の回復が想定以上に遅れた影響により、通期予想を下方修正

(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期予想		増減金額	
		前回予想 (11月公表)	今回予想 (2月公表)	前期比	前回予想比
設備投資額	173,901 (8.6%)	170,000 (8.3%)	160,000 (8.0%)	-13,901	-10,000
有形固定資産 減価償却費	108,757 (5.4%)	115,000 (5.6%)	115,000 (5.8%)	6,243	—
研究開発費	94,277 (4.7%)	106,000 (5.2%)	106,000 (5.3%)	11,723	—

注：（ ）内の数字は売上高比率

一部の設備投資を来期以降へ延期したことにより、設備投資額についても見直しを実施

# 2024年3月期 事業セグメント別売上高予想



(単位：百万円)

事業セグメント別 売上高	2023年3月期		2024年3月期予想				増減金額	
	金額	構成比	前回予想 (11月公表)		今回予想 (2月公表)		前期比	前回予想比
			金額	構成比	金額	構成比		
<b>コアコンポーネント</b>	<b>592,376</b>	<b>29.2%</b>	<b>567,000</b>	<b>27.6%</b>	<b>562,000</b>	<b>28.1%</b>	<b>-30,376</b>	<b>-5,000</b>
産業・車載用部品	199,194	9.8%	221,000	10.8%	222,000	11.1%	22,806	1,000
半導体関連部品	364,579	18.0%	315,000	15.3%	310,000	15.5%	-54,579	-5,000
その他	28,603	1.4%	31,000	1.5%	30,000	1.5%	1,397	-1,000
<b>電子部品</b>	<b>378,536</b>	<b>18.7%</b>	<b>358,000</b>	<b>17.5%</b>	<b>349,000</b>	<b>17.4%</b>	<b>-29,536</b>	<b>-9,000</b>
<b>ソリューション</b>	<b>1,068,597</b>	<b>52.8%</b>	<b>1,146,000</b>	<b>55.9%</b>	<b>1,109,000</b>	<b>55.5%</b>	<b>40,403</b>	<b>-37,000</b>
機械工具	308,406	15.2%	325,000	15.8%	316,000	15.8%	7,594	-9,000
ドキュメントソリューション	434,914	21.5%	473,000	23.1%	457,000	22.9%	22,086	-16,000
コミュニケーション	207,793	10.3%	231,000	11.3%	223,000	11.2%	15,207	-8,000
その他	117,484	5.8%	117,000	5.7%	113,000	5.6%	-4,484	-4,000
その他の事業	23,403	1.2%	18,000	0.9%	18,000	0.9%	-5,403	—
調整及び消去	-37,580	-1.9%	-39,000	-1.9%	-38,000	-1.9%	-420	1,000
<b>売上高</b>	<b>2,025,332</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,050,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>-25,332</b>	<b>-50,000</b>

# 2024年3月期 事業セグメント別利益予想



(単位：百万円)

事業セグメント別 利益	2023年3月期		2024年3月期予想				増減金額	
	金額	売上高比	前回予想 (11月公表)		今回予想 (2月公表)		前期比	前回予想比
			金額	売上高比	金額	売上高比		
<b>コアコンポーネント</b>	<b>89,475</b>	<b>15.1%</b>	<b>65,000</b>	<b>11.5%</b>	<b>57,000</b>	<b>10.1%</b>	<b>-32,475</b>	<b>-8,000</b>
産業・車載用部品	24,743	12.4%	24,500	11.1%	25,000	11.3%	257	500
半導体関連部品	67,702	18.6%	39,500	12.5%	31,000	10.0%	-36,702	-8,500
その他	-2,970	—	1,000	3.2%	1,000	3.3%	3,970	—
<b>電子部品</b>	<b>44,064</b>	<b>11.6%</b>	<b>24,500</b>	<b>6.8%</b>	<b>15,000</b>	<b>4.3%</b>	<b>-29,064</b>	<b>-9,500</b>
<b>ソリューション</b>	<b>42,239</b>	<b>4.0%</b>	<b>85,000</b>	<b>7.4%</b>	<b>70,000</b>	<b>6.3%</b>	<b>27,761</b>	<b>-15,000</b>
機械工具	23,279	7.5%	22,000	6.8%	17,000	5.4%	-6,279	-5,000
ドキュメントソリューション	33,706	7.8%	51,000	10.8%	45,000	9.8%	11,294	-6,000
コミュニケーション	-11,729	—	5,500	2.4%	5,000	2.2%	16,729	-500
その他	-3,017	—	6,500	5.6%	3,000	2.7%	6,017	-3,500
その他の事業	-28,795	—	-43,000	—	-44,000	—	-15,205	-1,000
<b>事業利益 計</b>	<b>146,983</b>	<b>7.3%</b>	<b>131,500</b>	<b>6.4%</b>	<b>98,000</b>	<b>4.9%</b>	<b>-48,983</b>	<b>-33,500</b>
本社部門損益等	29,209	—	38,500	—	42,000	—	12,791	3,500
<b>税引前利益</b>	<b>176,192</b>	<b>8.7%</b>	<b>170,000</b>	<b>8.3%</b>	<b>140,000</b>	<b>7.0%</b>	<b>-36,192</b>	<b>-30,000</b>

1 2024年3月期 第3四半期 決算概要

2 2024年3月期 業績予想

**3 政策保有株式の活用検討状況**

## 株式市場との対話を通じて認識した課題

『当社グループの更なる成長に向けて、政策保有株式を有効活用すべき』

### 今後の重要課題として具体的な施策を継続的に協議

#### 半導体産業向け投資

需要拡大を想定した  
生産能力の向上

- ◆ 滋賀八日市工場
- ◆ 鹿児島川内工場
- ◆ 長崎諫早工場 (仮称)

#### 戦略的M&A

高いシナジーが見込める  
事業領域を対象に検討

- ◆ 電子部品事業
- ◆ 機械工具事業 等

#### 経営基盤強化

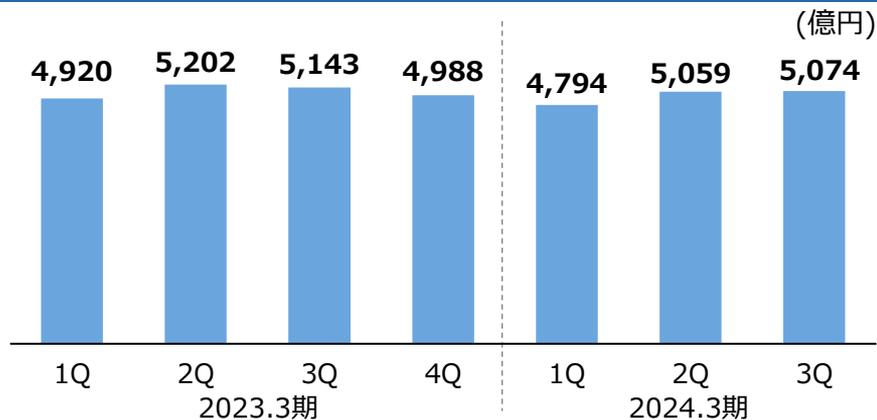
DX投資・人的資本投資の  
更なる拡充

- ◆ 生成AIの業務導入
- ◆ リスキリングの推進

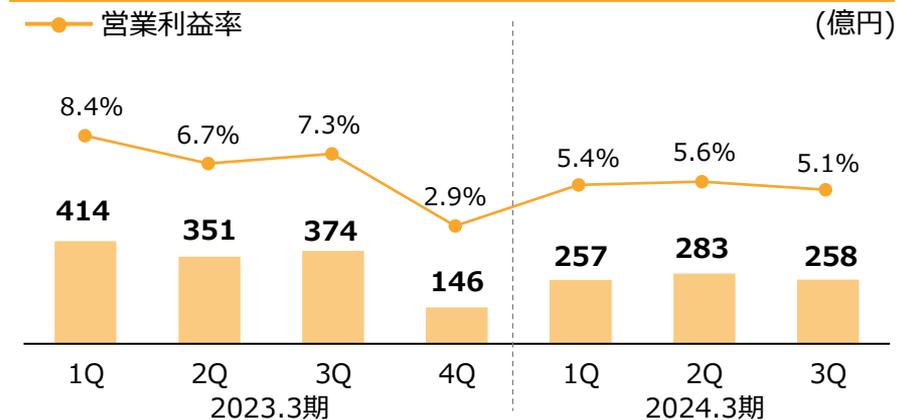
資金需要の明確化も含め、今後の資本政策を2024年秋以降に公表予定

**【ご参考】**  
**2023年3月期1Q～2024年3月期3Q**  
**四半期業績推移**

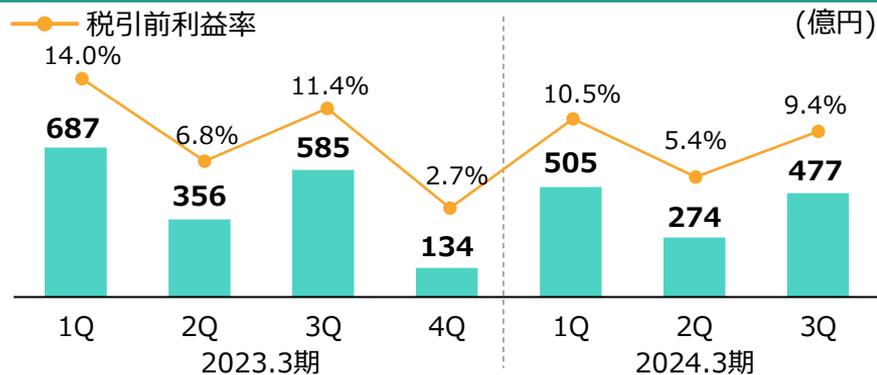
## 売上高



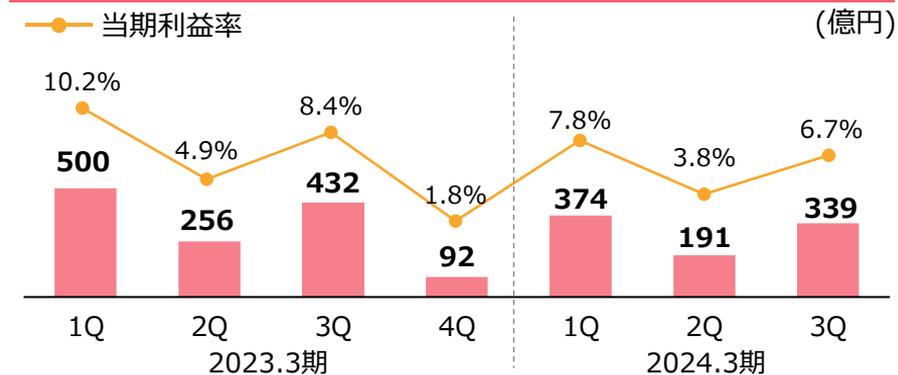
## 営業利益



## 税引前利益

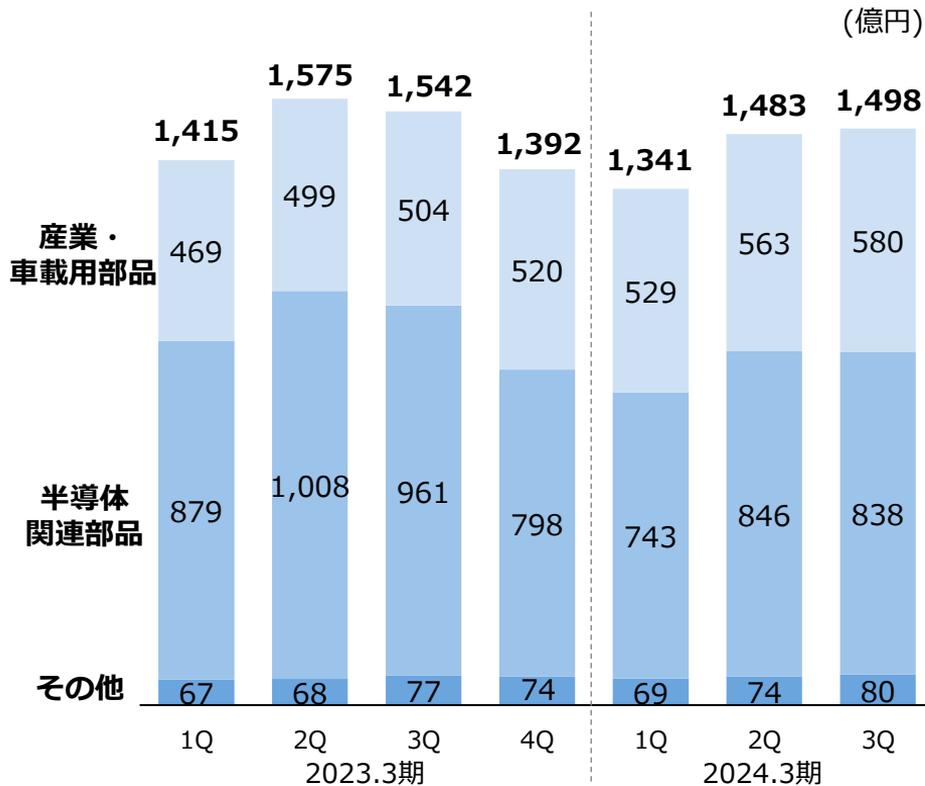


## 当期利益

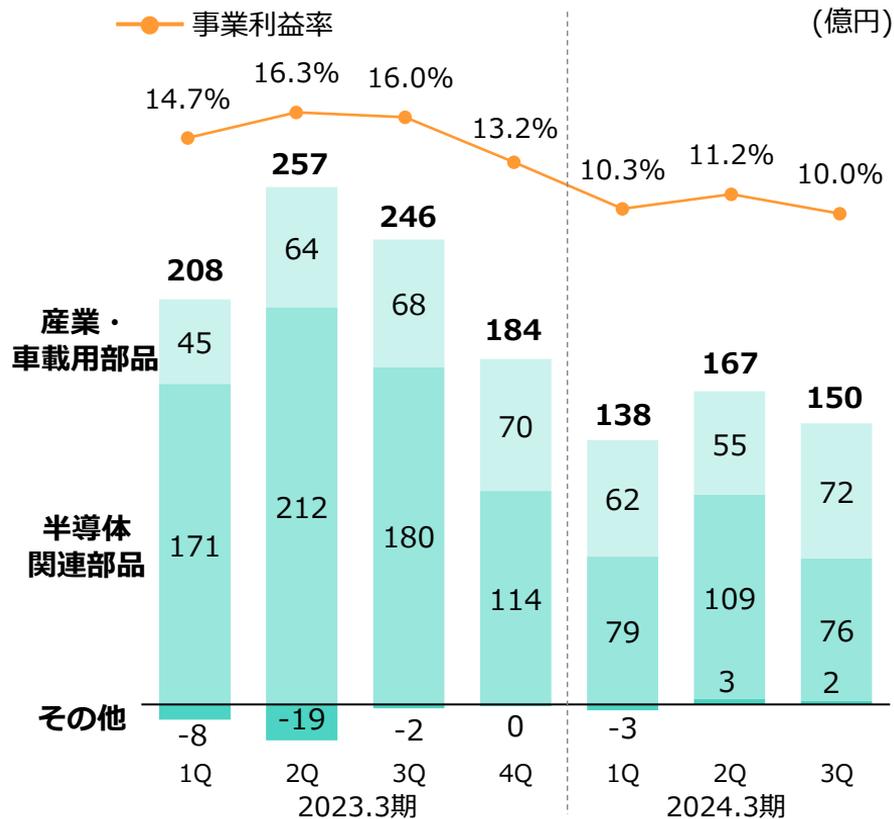


注：各利益率は百万円単位で算出

### 売上高



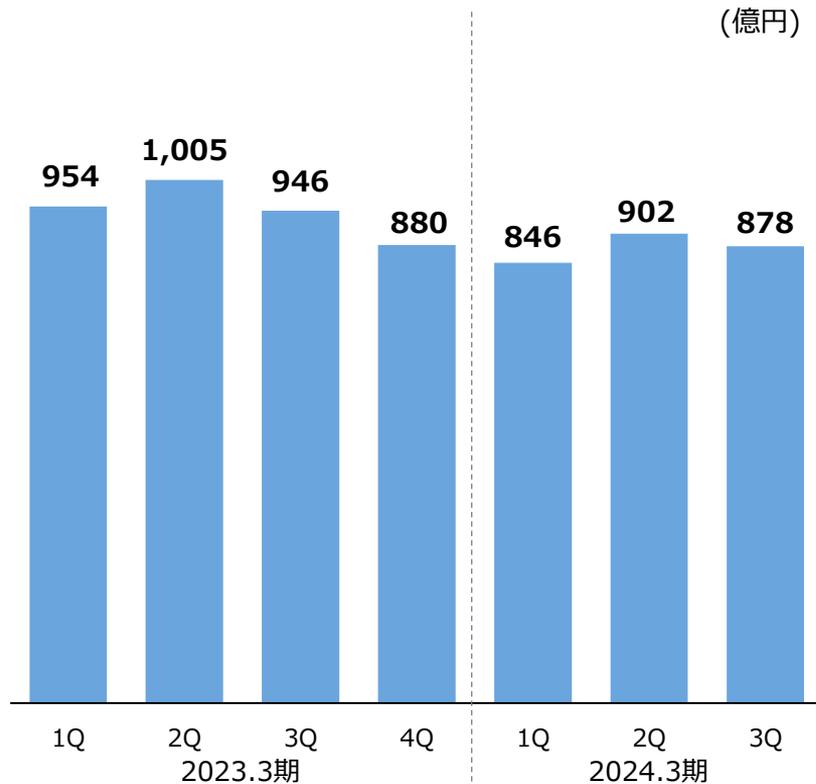
### 事業利益



注：事業利益率は百万円単位で算出

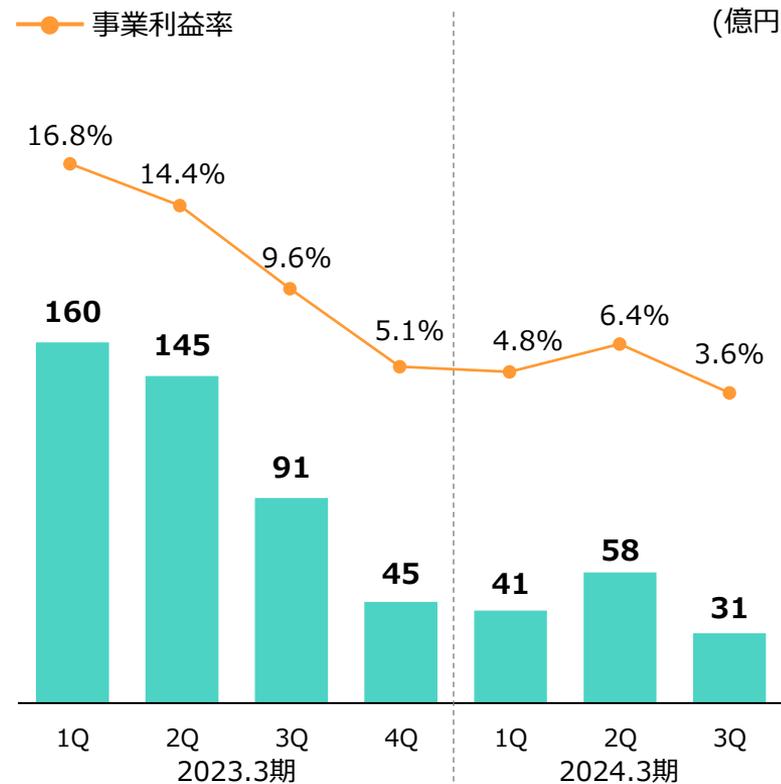
売上高

(億円)



事業利益

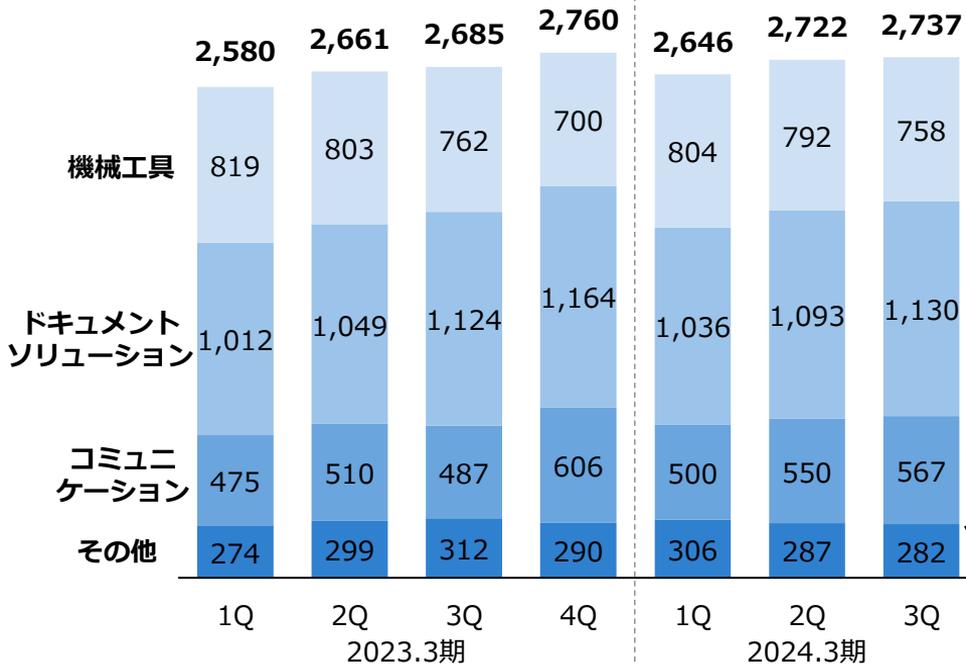
(億円)



注：事業利益率は百万円単位で算出

## 売上高

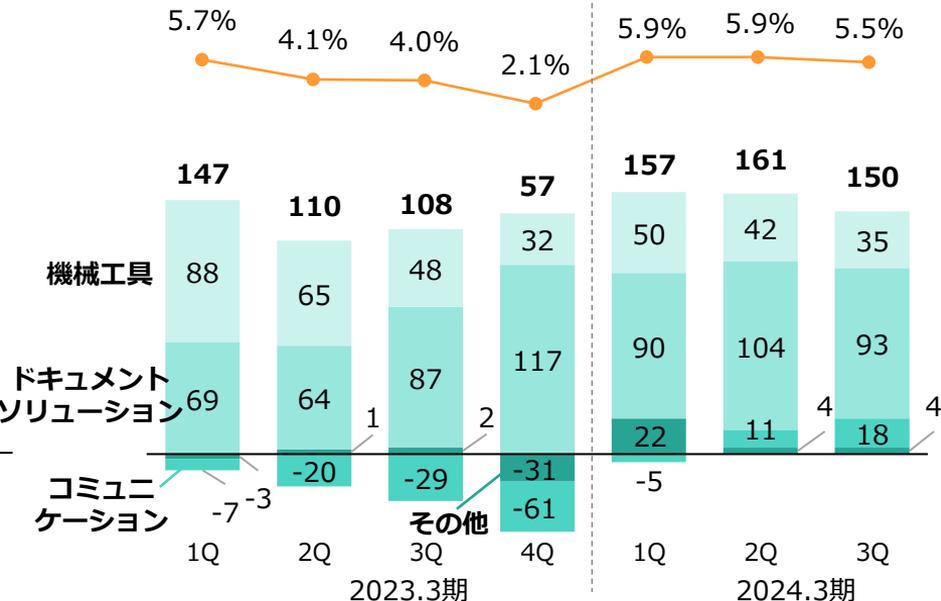
(億円)



## 事業利益

(億円)

● 事業利益率



注：事業利益率は百万円単位で算出

## 将来の見通しに関する記述等について

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の一般的な状況
- (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
- (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
- (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
- (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
- (8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
- (9) 優れた人材の確保が困難となる事態
- (10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
- (11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
- (12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
- (13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
- (14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
- (15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
- (16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
- (17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
- (18) 売掛債権の信用リスク
- (19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
- (20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
- (21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (22) 会計基準の変更

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。



京セラ株式会社